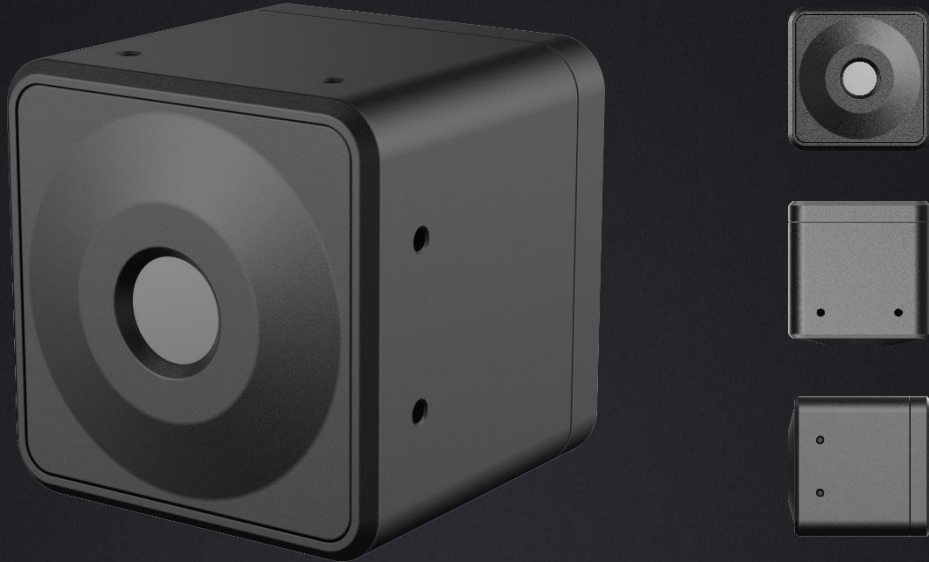


LE230 红外工业测温模块

99%已完成，助您轻松开发

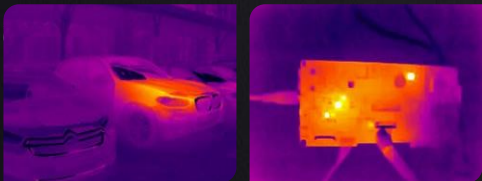


产品简介

LE230是一款专为工业终端设备集成而设计的全新红外测温模块，内置高德自主知识产权的256×192晶圆级红外探测器，可轻松赋予设备捕捉温度的能力。该产品采用通用USB协议，可以直接输出温度和图像，适配Linux/安卓等主流平台，帮助您轻松开发。

应用领域

- 作为工业终端设备的集成组件，适用于电子器件检测、机械电气维修、建筑暖通检测等应用场景
- 作为新兴智能安防产品的集成组件，适用于智能办公、智慧厨房、智慧养老等应用场景



产品特点

- 接口通用
采用通用USB协议，接口可选
- 直出温度/图像
直接输出温度和图像，减少红外相关的开发工作量
- 安装方便
四面均有通用安装孔位，安装更自由
- 尺寸通用
我司所有微型红外模块均可采用这种形态
- 多平台适用
可任意适配Linux/安卓等主流平台
- Demo齐全
主流平台均有Demo代码示例，降低开发难度

技术规格

产品型号	LE230
图像和光学	
探测器类型	WLP VOx
红外分辨率	256×192
像元间距	12μm
波长范围	8 ~ 14μm
视场角	56°±1°
NETD	≤50mK
红外帧频	25Hz
对焦方式	免调焦
测量与分析	
测温范围	-20°C~150°C, 100°C~550°C (自动切档)
测温精度	±2°C或±2%, 取大值
数据格式及接口	
对外接口	USB Type-C母头 (USB Type-C公头、4PIN可选)
数据格式	USB 2.0
电源及功耗	
电压	4.5~5.5V
典型功耗	≤650 mW
配套软件	
SDK	Android/ Linux/ Windows
DEMO演示软件	PC端/安卓端
环境参数	
工作温度	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C
认证	RoHS
物理参数	
重量	≤ 50g
尺寸 (长×宽×高)	33mm×33mm×33.4mm

